

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	中泰证券 兴证全球基金 宝盈基金 浦银安盛基金 景顺长城基金 国投瑞银基金 生命保险 惠升基金 万向三创投资 鹏华基金 睿郡资产 光大保德信基金 华安证券 西藏信托 英大国际信托 国泰海通证券 申万宏源证券 中信证券 国力民生
时间	2025年7月25日
地点	上海浦东香格里拉酒店及线上会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、硅零部件业务的长期需求</b></p> <p>中国本土存储类集成电路制造厂商的产能和技术能力，正在赶超世界一流水平，相应带动中国本土等离子刻蚀设备厂商的国产机台出货持续增加，将带动硅零部件作为关键耗材的需求。</p> <p>此外，随着中国本土近年集中新建的集成电路制造产线工艺日益稳定、工程师队伍日益成熟，其现存海外高端机台未来的硅零部件技改需求也会持续增加。</p> <p>随着全球科技巨头对算力相关高端存储芯片的持续巨额投资，在技术上要求更多的刻蚀次数和更大的产能，相应带动硅零部件的消耗及刻蚀设备的出货量增加。</p> <p>因此，公司认为硅零部件市场的中长期需求增长可期。</p> <p><b>二、多晶硅原料价格上涨对公司毛利率的影响</b></p> <p>近期，国家有关部门及行业协会强调：要深化要素市场化配置改革，强化行</p>

业自律，主动破除“内卷式”竞争，一批相关政策相继出台。一些业内人士认为，这将对某些大宗商品（例如多晶硅）的价格产生影响。

公司注意到，近一个月来，多晶硅期货价格的变化幅度，远大于现货价格变化幅度。因此，期货价格受到的市场关注度更高，社会影响面更大。

公司密切关注多晶硅原料现货价格：目前现货价格短期涨幅有限，仅略高于上游多晶硅原料厂商的成本线，远低于2021年至2022年的平均价格水平，仍处于历史低位。未来多晶硅原料价格的长期走势，取决于下游光伏产业实际需求的恢复程度以及多晶硅原料全行业产能出清的实际力度。

公司采购现货多晶硅，目前价格上涨对毛利率的影响可控。公司还将继续通过提高生产效率、技术创新、规模效应等方式降低生产成本。

### **三、硅片业务的行业环境变化**

公司注意到，半导体硅片产业在因时而变。在8吋轻掺抛光硅片领域，具备全球竞争优势和寡头垄断地位的日本厂商，正在将更多产能调配至12吋轻掺抛光硅片，以在不额外增加资本开支的前提下，改善其盈利能力。

考虑到中国本土8吋轻掺硅片的潜在市场需求仍然存在增长，日本厂商的动向有望扩大国产化空间。公司作为国内少数具备8吋轻掺抛光硅片技术和生产能力的企业，有望在行业供求关系的变动中，发挥自身独特技术优势，优化变动成本，改善竞争地位。

### **四、硅零部件业务的扩产进度**

土地、厂房、设备等生产要素的整备只是基础条件，“人机结合”更为关键，乃是一项系统工程。经过过去数年的连续扩产，该业务目前对公司的管理效率提出了更高要求乃至挑战。扩产的质量和扩产的速度需要保持最佳平衡，才能保障公司持续健康发展。

因此，公司将以下游客户订单为基础扩大产能，努力保持良率及毛利率水平，继续保持以高端产品为主的销售结构，满足中国本土硅零部件国产化的需求。

## 五、半导体材料及零部件企业的外延式发展路径

当前，中国半导体本土供应链建设进入“深水区”，零部件领域特别是上游材料领域的“硬骨头”已经水落石出，“卡脖子”风险凸显，本土集成电路制造厂和设备原厂的需求日益迫切。

公司认为，迫切需求的背后是客户的超高预期：这些“硬骨头”处于关键工艺节点，对供应商对技术原理的理解和工艺积累的要求极高。一旦出现风险事件，客户方发生的损失巨大。因此，此类外延式发展对公司的研发能力和管理整合能力提出更高要求——“拿来主义”不可取，“跨界拼盘”风险大。

管理层将基于自身在半导体硬脆材料领域的技术和经验积累，结合海外市场的资源和信息优势，通过拓展多种渠道和合作伙伴，巩固并扩展能力圈，积极稳妥地推动公司高质量发展。

## 六、公司年内是否有再融资计划

《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条规定：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。”

因此，包括公司在内的众多上市公司，往往会选择在年度股东大会审议关于该项授权的议案。上市公司董事会获得授权后，并不必然行使该权力。

公司已于2025年4月19日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案。

目前，公司前次再融资的募投项目仍在实施中，尚未结项。至于年内是否进行新一轮再融资，董事会将在股东大会授权范围内，综合考虑全体股东利益、公司发展需求以及前次再融资募投项目实施进度而定。

附件清单	无
日期	2025年7月28日